

四半期連結財務諸表

注：四半期連結財務諸表の数値は百万円以下を切り捨てて表示しています。

四半期連結貸借対照表

単位：百万円

科目	前連結会計年度末に係る 要約連結貸借対照表 (08.03.31)	当第2四半期 連結会計期間末 (08.09.30)
(資産の部)		
流動資産	77,603	70,678
固定資産	30,063	30,996
有形固定資産	18,969	20,311
無形固定資産	3,188	3,083
投資その他の資産	7,905	7,601
資産合計	107,667	101,675
(負債の部)		
流動負債	44,540	37,444
固定負債	7,640	11,036
負債合計	52,180	48,480
(純資産の部)		
株主資本	55,081	53,305
資本金	9,633	9,639
資本剰余金	20,653	20,658
利益剰余金	24,900	23,115
自己株式	△ 105	△ 106
評価・換算差額等	29	△ 517
その他有価証券評価差額金	65	△ 276
為替換算調整勘定	△ 35	△ 241
新株予約権	375	407
純資産合計	55,487	53,194
負債純資産合計	107,667	101,675

四半期連結損益計算書

(第2四半期連結累計期間) 単位：百万円

科目	前第2四半期 連結会計期間末 (07.04.01~07.09.30)	当第2四半期 連結会計期間末 (08.04.01~08.09.30)
売上高	49,868	31,806
売上原価	37,103	24,118
売上総利益	12,764	7,687
販売費及び一般管理費	6,865	5,556
営業利益	5,899	2,130
営業外収益	469	631
営業外費用	403	191
経常利益	5,964	2,571
特別利益	—	—
特別損失	5	2,559
税金等調整前四半期純利益	5,959	11
法人税、住民税及び事業税	1,252	1,194
法人税等調整額	1,361	△ 996
四半期純利益(純損失△)	3,345	△ 186

四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(第2四半期連結累計期間) 単位：百万円

科目	前第2四半期 連結会計期間末 (07.04.01~07.09.30)	当第2四半期 連結会計期間末 (08.04.01~08.09.30)
営業活動によるキャッシュ・フロー	4,497	2,270
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 3,573	△ 1,261
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,767	53
現金及び現金同等物に係る換算差額	36	△ 94
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	△ 1,806	967
現金及び現金同等物の期首残高	16,800	15,665
連結子会社増加に伴う現金及び現金同等物の増加額	175	—
現金及び現金同等物の四半期末残高	15,168	16,632

四半期連結株主資本等変動計算書

(第2四半期連結累計期間) 単位：百万円

第86期 (08.04.01~08.09.30)	株主資本				株主資本 合計
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	自己株式	
前連結会計年度末(08.03.31) 残高	9,633	20,653	24,900	△ 105	55,081
当連結会計期間中の変動額	5	5	△ 1,607	△ 186	10
新株の発行					
剰余金の配当					
四半期純損失					
自己株式の取得				△ 1	△ 1
自己株式の処分				0	0
その他		△ 0			0
株主資本以外の項目の変動額(純額)			9		9
当連結会計期間中の変動額合計	5	4	△ 1,784	△ 0	△ 1,775
当第2四半期連結累計期間末(08.09.30) 残高	9,639	20,658	23,115	△ 106	53,305
第86期 (08.04.01~08.09.30)	評価・換算差額等			新株 予約権	純資産 合計
	その他有価証券 評価差額金	為替換算 調整勘定	評価・換算 差額等合計		
前連結会計年度末(08.03.31) 残高	65	△ 35	29	375	55,487
当連結会計年度中の変動額					
新株の発行					10
剰余金の配当					△ 1,607
四半期純損失					△ 186
自己株式の取得				△ 1	△ 1
自己株式の処分				0	0
その他				9	9
株主資本以外の項目の変動額(純額)	△ 341	△ 206	△ 547	31	△ 516
当連結会計期間中の変動額合計	△ 341	△ 206	△ 547	31	△ 2,292
当第2四半期連結累計期間末(08.09.30) 残高	△ 276	△ 241	△ 517	407	53,194



第86期 第2四半期株主通信

(平成20年4月1日~平成20年9月30日)

株式会社 東京精密

ごあいさつ

株主の皆様には、ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

第86期第2四半期(平成20年4月1日から平成20年9月30日まで)の株主通信をお届けするにあたり、ご挨拶申し上げます。

当第2四半期連結累計期間における当社をとりまく経営環境は、半導体事業において設備投資が停滞していることに加えて、米国発の金融危機を背景にした景気減速懸念が高まったことにより、さらに厳しさを増しました。

このような状況のもと、半導体製造装置部門の売上高が192億2千7百万円(前年同期比49.6%減)となり、営業損失は5億5千6百万円となりました。一方、計測機器部門は、需要が堅調に推移し、売上高は125億7千8百万円(前年同期比7.6%増)となりましたが、営業利益は26億8千7百万円(前年同期比9.4%減)と若干の減少となりました。

また、棚卸資産の評価に関する会計基準が平成20年4月から適用されたことに伴う在庫評価損25億1千9百万円を主な要因として、特別損失を25億5千9百万円計上しました。

これらの結果、当社グループ全体として売上高318億6百万円(前年同期比36.2%減)、営業

利益21億3千万円(前年同期比63.9%減)、経常利益25億7千1百万円(前年同期比56.9%減)、四半期純損失は1億8千6百万円と非常に残念な結果となりました。

なお、当第2四半期の受注高は、半導体製造部門で151億8千5百万円(前年同期比57.3%減)、計測機器部門で122億8千8百万円(前年同期比0.1%増)となっています。

配当につきましては、連結業績、財政状況、事業拡大のための投資および株主様の長期的視点等を考慮し決定しており、具体的には連結当期純利益に対する配当性向30%の配当を行うことを目指しています。当第2四半期は市況が低迷し厳しい環境下ではありますが、株主の皆様との長期的な関係を考慮し、当中間配当金は一株当たり15円とさせていただきます。

今後とも、事業環境は不透明な状態が続くと思われませんが、当社は企業体質の強化と将来の成長への準備を着々と進めてまいります。

株主の皆様方におかれましては、今後とも倍旧のご支援とご鞭撻を賜りますよう、お願い申し上げます。

代表取締役会長
鈴木 貞勝代表取締役社長
藤森 一雄

代表取締役会長 鈴木 貞勝

鈴木貞勝

代表取締役社長 藤森 一雄

藤森一雄

会社概要

(2008年9月30日現在)

商号	株式会社 東京精密 (TOKYO SEIMITSU CO., LTD.)	国内拠点	業務会社 半導体社 計測社 半導体関連営業所 計測関連営業所 グループ会社	東京都三鷹市 東京都八王子市 茨城県土浦市 4ヶ所 20ヶ所 5社 16拠点
設立	1949年3月28日	海外拠点	北アメリカ ヨーロッパ アジア	9ヶ所 4ヶ所 15ヶ所
資本金	9,639,123,563円	株式の状況	株主名	持株数(千株) 出資比率(%)
証券取引所 会社が発行する	東京証券取引所 市場第一部	日本マスタートラスト 信託銀行株式会社(信託口)		4,416 11.0
株式の総数	110,501,100株	日本トラスティ・サービス 信託銀行株式会社(信託口)		2,486 6.2
発行済株式 の総数	40,232,181株 (うち、自己株式数30,335株)	野村信託銀行株式会社(投信口)		1,155 2.9
株主数	33,773名	財団法人精密測定技術振興財団		1,058 2.6
役員	代表取締役会長 鈴木 貞勝 代表取締役社長 藤森 一雄 代表取締役CFO 太田 邦正 業務会社執行役員社長 梅中 茂 取締役 取締役 ウォルフガング ボナツ 取締役 取締役 吉田 均 計測社執行役員社長 取締役 木村 龍一 半導体社執行役員社長 監査役(常勤) 高城 英明 監査役 久富 眞志 監査役 川原 栄次 監査役 高田 有	株式会社みずほコーポレート銀行		840 2.1

従業員数

713名(単体) 1,290名(連結)

主要取引銀行	みずほコーポレート銀行大手町営業部 三井住友銀行本店営業部 みずほ信託銀行本店営業部 三菱東京UFJ銀行新宿中央支店 常陽銀行土浦支店 関東つくば銀行本店営業部 りそな銀行吉祥寺支店
--------	---

所有者別状況

(株式数比率)



株主メモ

事業年度	毎年4月1日~翌年3月31日
剰余金の配当 基準日	3月31日 (中間配当を行う場合は9月30日)
定時株主総会	毎年6月下旬
単元株式数	100株
株主名簿管理人	東京都中央区八重洲1丁目2番1号
事務取扱場所	みずほ信託銀行株式会社 本店証券代行部
郵便物送付先	〒135-8722 東京都江東区佐賀1-17-7 みずほ信託銀行 証券代行部 TEL:0120-288-324(フリーダイヤル)
※	平成21年1月5日より、当社株主名簿管理人であるみずほ信託銀行への郵便物送付先が、移転のため以下の通り変更となります。 〒168-8507 東京都杉並区和泉2丁目8番4号
※	買取・買増関連のいずれのお手続きも、株券電子化への移行に伴い、電子化前後はお手続きの受付を停止させていただくことがありますのでご留意願います。

公告方法 電子公告(ホームページ)
ただし、やむを得ない事由によって、電子公告による公告をすることができない場合には、日本経済新聞に掲載して行います。

TOKYO SEIMITSU
http://www.accuretech.jp

当第2四半期の業績をどのように評価されていますでしょうか？

当第2四半期の事業環境は半導体製造装置メーカーにとって非常に厳しいものでした。DRAMを中心としたメモリーの供給過剰により半導体メーカーが設備投資を抑制する状況が続いています。この設備投資抑制は、期初の予想よりも大きくまた長引くものと見られます。特にテスト工程の装置における需要の落ち込みは、後工程のものなどと比較しても激しい状況です。

このような状況下、第1四半期終了時に市場の悪化を反映して第2四半期業績予想を下方修正させていただきましたが、当第2四半期は概ねその修正された水準となりました。第3四半期以降の市場動向は金融危機の実体経済への反映により、一段と厳しいものになりそうです。

特に半導体事業の、この厳しい状況をどのように乗り切っていくかをお考えでしょうか？

半導体事業はシリコンサイクルの影響を受けています。しかしながら、半導体事業は今後も大きな成長が望める事業でありますし、半導体製造装置は、それに合わせて成長する事業です。今、東京精密にとって必要なことは、以下の2点です。

◇ 全社を挙げて、厳しい不況の時期でも利益が出せる筋肉質の企業体質を構築し、市況が回復した時には、これまで以上の利益を確保できるような体制を作っていくこと

◇ 中長期的には、今後の成長を目指し、また、シリコンサイクルの影響を低減できるような新たな事業を加えた事業ポートフォリオと事業内容を構築していくこと

それぞれ、具体的にご説明いただけますでしょうか？

まず、最初の点に関して、現在全社をあげての固定費と変動費の両面で徹底したコストダウンに取り組んでいます。中でも、最も重要なものは、生産性の効率化によるコストダウンを図ることです。現在、進めている八王子工場の拡張計画も、生産の量的拡大を目指すのではなく、いかに生産効率を上げていくかを主眼としたものです。これは長い目で見た時に、必ず東京精密の成長を牽引するものと確信しており、株主の皆様のご理解を得たいと考えています。

また、第二の中長期的な観点からの施策も着実に展開しています。前期の株主通信でもご説明しましたが、私は東京精密の事業を三つのセグメントに分けて見るのが妥当と考えます。ウエーハブロービングマシンとそれ以外の半導体製造装置、それに計測機器事業の三つです。この三つの分野へは今後とも積極的に研究開発費を充当し、設備投資を図っていきます。

また、半導体製造装置事業の現行製品の用途を拡大することにより、事業の枠を拡大していくことが重要です。即ち、東京精密の主力製品であるウエーハブロービングマシンを更に幅広い半導体ICの検査に活用できるようにし、ICの多様化に伴う各デバイスに特化した製品を展開していくことが必要です。また、ウエハダイシングマシンにおいてもLEDなどの市場を含め、幅広い用途に効率的に対応できるような製品を開発することにより、市況の変化による業績への影響を軽減できるはず です。

計測器部門の今後の課題は何かでしょうか？

計測器部門は売上と利益の両面で、これまで順調に拡大してきています。しかしながら、この市場環境が永遠に続く保証はありません。私は、計測事業においては二つの方向性を追求すべきと考えています。ひとつは、現在の需要を最大限に売上に結びつけることです。土浦に建設しました計測センターはお客様に当社の計測機器のラインアップと強みを紹介し、またお客様のトレーニングやセミナーも実施することができ、事業拡大には大きなプラス要因になると見えています。

もうひとつは、現在の計測機器の事業は自動車産業の需要に支えられていますが、自動車産業以外の産業にいかに当社の計測技術・計測製品を使っていだくかが、今後の大きな課題となります。これらは中長期的な課題となりますが、当社の計測事業の更なる拡大のためには不可欠な要素と考えています。

株主の方々へのその他メッセージがあればお聞かせください。

東京精密を取り巻く環境はこれまで以上に大きく変化していくと考えられます。これらの変化する事業環境の中で生き残り、大きく成長していくために、企業に求められる要素があるはず です。私は、以下の三つが大きな鍵になると考えています。

- 1) 安全と健康
- 2) 品質
- 3) 環境

この三つはグループのすべての企業が追及すべき課題です。特に、環境は今後より大きな問題になると考えています。お客様の現場でのエネルギー削減にいかに貢献できる製品を作るかが、製品の差別化を図っていく上で重要な要素になるのではないのでしょうか。また、二番目にあげた品質については、従業員個々人の仕事の品質が、製品の品質であり、その蓄積が企業としての品質を築き上げると考えています。先にお伝えした「計測センター」では、土浦工場にお客様をお迎えすることになります。つまり、営業やサポートだけでなく、製造や事務の人間も当社の顔となるのです。来ていただいた皆様に「来て見て良かった」と思ってもらえるようにしていきたいと思っています。

現在、東京精密は非常に厳しい事業環境の下にあります。しかしながら、私たちは何もしないで市況の好転を待っているわけではありません。より大きな成長を目指し、さまざまな角度から、さまざまな手を打っています。これらが成果として花開き、私たちが掲げる「WIN-WIN」のすべての関係者が利益を享受できるまで、もうしばらくご辛抱いただきますようお願いいたします。

代表取締役社長 藤森 一雄

“私たちはただ市況の好転を待っているわけではありません。より大きな成長を目指し、さまざまな角度から手を打っています。”

アンケートで寄せられたご質問にお答えします。

第84期の株主通信において実施しました株主アンケートにご協力いただきましてありがとうございました。また、株主様の貴重なご意見を頂戴しありがとうございます。その中から、以下の質問にお答えさせていただきます。

貴社の製品を実際に見ることは可能でしょうか？

当社の製品は大半が製造工程で使用されるものであり、一般の皆様が目に見えることは少ないと思います。当社製品は当社ホームページや各種の出版物で写真を見ることが出来ますが、現物が見られている現場を見ることは稀です。当社製品のうち、半導体製造装置は半導体メーカーの研究所や工場のクリーンルームの中で、セキュリティーの整った環境下で使用されています。これらの使用環境は、「工場」から連想される労働集約型の現場ではなく、研究機関のようなものです。計測機器は、種類にもよりますが、温度管理のなされた非常に整った環境で使用されるものと、温度変化や振動のある工場ラインサイドで使用されるものがあります。詳しくは当社WEBサイトをご参照ください。<http://www.accretech.jp/top/product/>

半導体製造装置の市場動向予測はなぜ難しいのでしょうか？

従来ほど大きな変化ではないにしても、シリコンサイクルはなくなっておりません。これとは別に、半導体製造プロセスにおける技術的な進化に伴い、新しい、より高度な製造装置が必要とされる傾向があります。半導体製造装置の需要はシリコンサイクルと製造技術の変化の両方の影響を受けることとなります。以上より、半導体製造装置の市場動向予測は非常に難しいものとなり、結果として当社の業績が予想と乖離することがありますが、出来るだけ確度の高い予想となるよう努めていきます。

半導体製造の工程によってなぜ業績が異なるのか？

半導体製造装置は前工程と後工程、それにテスト工程の大きく3工程の装置に分かれており、それぞれ業績の動きが異なります。前工程の装置は、

大きく、高価で、発注から納品までの期間が長いという特徴があるので、早い時期に売上を予想することができます。これに対して、テスト工程と後工程の装置は、単価が比較的低く、納期が短いので、発注側も必要となる直前に購買決定を行う傾向があります。このような購買決定時期の相違が売上の波の相違となって現れます。また工程・装置ごとに、競合状態も異なり、これも業績に影響します。

業績が厳しい中、八王子工場増設に対する投資の背景は？

八王子に工場を増設しており、この完成予定が2009年度ごろとなっております。この投資は、生産能力増というよりは効率的な生産を行う為の設備であり、生産コストが大きく下がる事を期待しています。

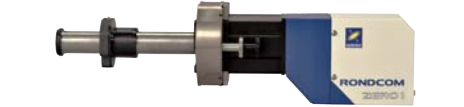
海外事業展開について知りたいのですが？

当社の主力製品である半導体製造装置の事業は、世界の半導体製造工場がお客様です。現在世界の半導体生産は、国外では、韓国、台湾、中国、東南アジア等のアジア地域が中心となっており、従来半導体製造が盛んであった、米国と欧州からの生産シフトが起きている。半導体製造装置においては、海外売上比率が60%を超えており、計測事業においても、海外売上比率の増加を計画しています。全体としての海外売上比率は50%を超えており、当社の事業は非常に国際的なものといえます。

新製品

真円度・円筒形状測定機 [RONDCOM Zero 1]

「RONDCOM Zero 1」は、エンジンのシリンダーブロックの直径φ65～φ100mmのボア穴の内径を測定する真円度測定機です。軽量コンパクト設計で、生産現場でのセッティングが容易に出来るようにワンタッチセンタリング機構を設けています。



「RONDCOM Zero 1」

三次元座標測定機 「DuraMax」

「DuraMax」は、耐環境性を追及し、省フットプリント設計、エア源不要化により、測定機を生産現場への設置と管理が格段に容易になったカールツァイス社製小型CNC三次元座標測定機です。測長スケールには低熱膨張のガラスセ

ラミックス、ガイド部とスケール部にはダストやオイルミストをシャットアウトする防塵構造を採用し、現場環境下でも安定した測定精度を保証します。また、測定ヘッドには、低測定圧かつ広域可動範囲を持つ小型スキニングセンサー「VAST XXT」を標準装備し、スタイラス自動交換用のマガジンも備え、生産現場でのあらゆる測定要求に対しこの1台で応えます。



「DuraMax」

非接触表面粗さ形状測定機「LPS5000」

当社の技術提携先である三鷹光器(株)のレーザプローブ センサーを採用した非接触表面粗さ形状測定機「LPS5000」は従来の測定触針式では傷が付いてしまうレンズやICチップなどのハンダ形状などの軟質材、工作機械用バイトの刃先の様な光沢のある鋭利な形状など従来非接触測定が困難とされていた物を対象にした非接触表面粗さ形状測定機で、触針式の測定結果との高い整合性を特長としています。



「LPS5000」